

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☒ 现场调研 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	浙商证券 2025 年一季度机构重仓股交流会、大成基金、华安证券
调研时间	2025 年 2 月 13 日
会议地点	浙商证券 2025 年一季度机构重仓股交流会会场、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、执行总裁、董事会秘书：肖青女士 董事、财务总监：刘鹏先生 投资者关系：刘文鑫女士
投资者关系 活动内容记录	1、公司近期经营进展？DeepSeek 火爆之后，对掩膜版行业及公司有何影响？ 2024 年下游行业需求旺盛，公司积极进行技术升级与产能提升，延续此前增长态势。2025 年开年以来，DeepSeek 大模型火爆，预计带动很多终端产品的更新迭代，科技改变生活。掩膜版作为第三大半导体材料，在当前 AI、机器人的快速发展背景下，同样迎来了巨大的发展机遇，公司立足自身技术实力、客户实力等等综合竞争力，同时不断推进产能提升以应对旺盛的市场需求，以期在当下市场中取得更好的发展成果，公司对未来增长充满信心，感谢各位投资者的关注！ 2、公司在先进封装方面的布局？ 公司已在先进封装方面前瞻布局、精耕细作发展多年，积累了深

厚的技术底蕴，汇聚了丰富、优质的客户资源。从行业整体的发展态势来看，下游众多传统封装客户正加速向先进封装转型，积极拥抱技术迭代浪潮，为掩膜版行业、公司带来了更为广阔的市场空间与蓬勃的发展机遇。随着 AI 需求爆发，应用于 AI 的先进芯片，需要同时实现高速、节能以及成本控制。以台积电的 CoWoS 先进封装为例，通过把芯片堆叠起来封装在基板上，来减少芯片所需空间，同时还能降低功耗和成本。近期，半导体封装巨头日月光投控宣布将扩大其 CoWoS 先进封装产能，并与 AI 芯片巨头英伟达的合作更加紧密。

公司作为国内先进封装掩膜版的龙头企业，是多个领先封测厂的头部供应商，技术和产品布局全面，产品可满足 CoWoS 等先进封装要求；玻璃基板封装亦实现供货。

3、公司的掩膜版在新能源汽车、机器人上面有哪些应用？

公司的掩膜版主要用于平板显示、IC 制造、IC 器件、IC 封装、MEMS（微型传感器）、LED 芯片、PCB 制造等等领域。新能源汽车在芯片、器件、屏幕上的使用量和种类相较传统燃油车的增长是十分可观的，这极大带动了对掩膜版的需求。机器人上面同样存在多种芯片、屏幕、PCB 以及多种传感器，这些在制造过程中都需要使用到掩膜版。

4、2025 年是否有新的市场拓展计划？

立足现有主业，公司将持续进行产能扩充和技术升级，提升市场份额。重点市场包括高世代 TFT-LCD、高精度 AMOLED、Micro LED 对应的平板显示掩膜版领域以及半导体掩膜版领域。

目前公司再融资项目、路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目都在有条不紊的推进中。同时公司亦会以自有或自筹资金不断进行设备产线投资，升级产线，提升规模。

5、公司如何在竞争中保持领先性，针对不断推进制程节点，做了哪些准备？

在技术研发方面，公司积极与国内高校、知名客户、实验室等开展自研和共研，制定了具备前瞻性的技术研发规划。目前，公司已针对干法刻蚀、等离子束修补、半导体 PSM 工艺、电子束光刻、模拟光

	刻、反演光刻等等技术开展了一系列研究，并形成了一定的技术积累。 公司投资的路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目在有条不紊的推进，设备按计划有序采购，部分设备已于 2024 年年底开始陆续到场。该项目一期投资 14-16 亿元，覆盖 40nm 制程节点以上掩膜版；二期投资 4-6 亿元，覆盖 28nm 制程节点以上掩膜版。因此一期采购的大部分辅助设备可以覆盖到 28nm。 6、公司是否考虑并购重组？ 公司对并购重组持积极态度，目前考虑的方向包括但不限于产业链上下游拓展、海外/国内同业并购、合适的跨界布局等等，若市场上存在协同性较高的优质资产，公司会积极接洽，具体进展请各位投资者关注公司公告。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单	无